

特点:

- 低插入损耗: 最大值 3.5 dB
- 高阻带抑制:
最小值 60dB @ $f_c \pm 60\text{MHz}$
- 良好的带内驻波比: 典型值 1.5:1
- SMT 封装
- 封装尺寸: 25.7*8.1*5.7mm
- 产品执行标准为 SJ20527A-2003

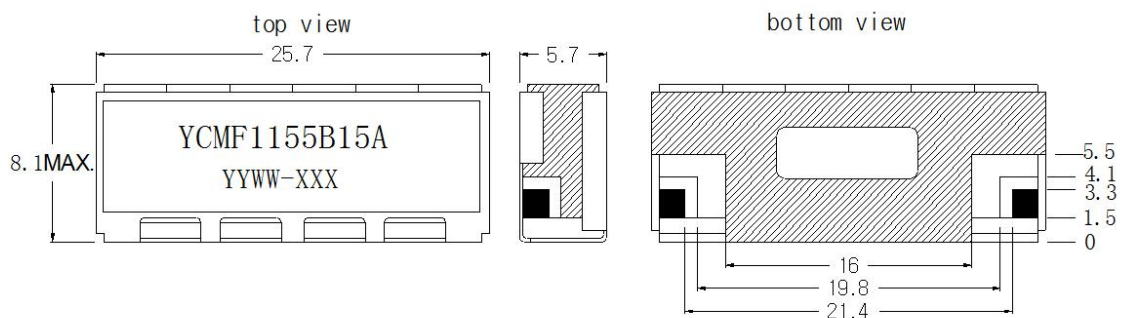
性能参数 (25℃):

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
中心频率	f_c		1155±0.5			MHz	全温
-3dB 带宽	BW_{-3dB}		30			MHz	全温
插入损耗	IL	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=f_c$			3.5	dB	全温
输入带内驻波比	VSWR _i	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=f_c \pm 15\text{MHz}$		1.5:1	2.0:1		全温
输出带内驻波比	VSWR _o			1.5:1	2.0:1		全温
阻带抑制	SR _i	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=f_c \pm 60\text{MHz}$	60			dB	全温
端接阻抗				50		Ω	
工作温度	T		-55		+85	℃	
质量	m				20.0	g	

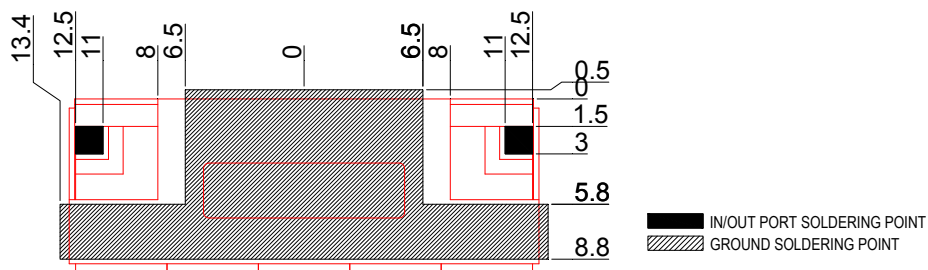
极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
储存温度	-55~+100	℃	输入射频功率	30.0	dBm

封装外形及引脚标识图:



推荐焊装图:



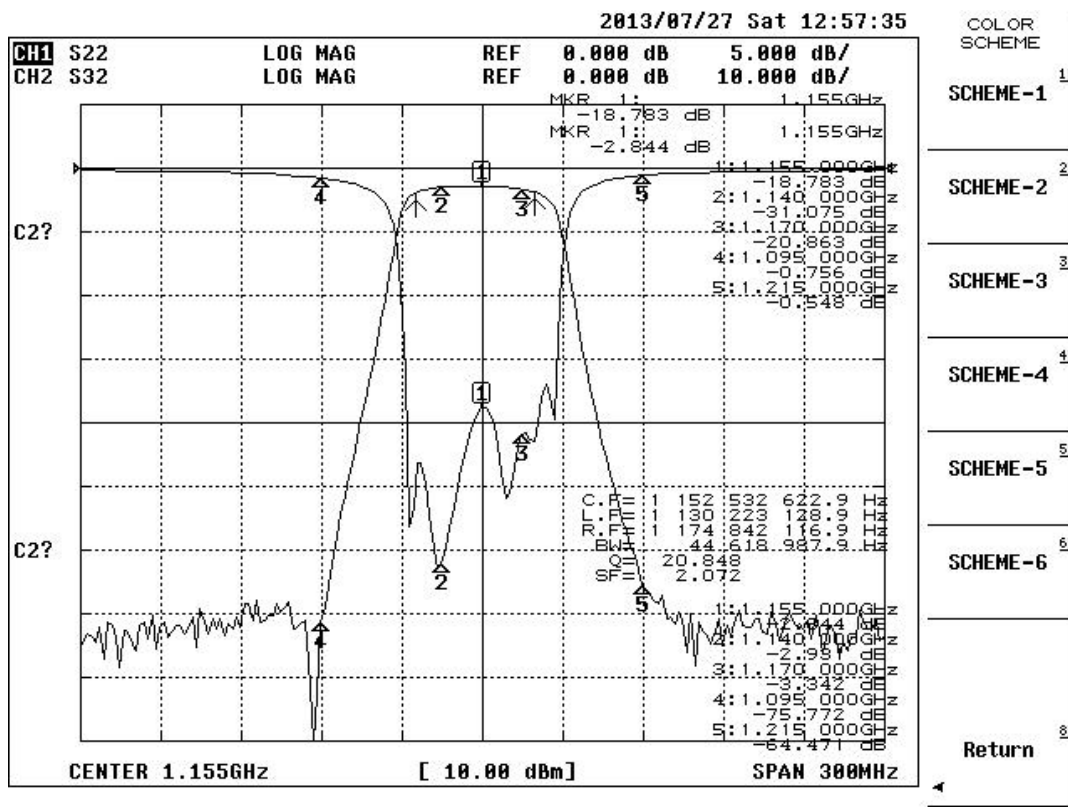
字符标志:

YCMF1155B15A	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义：

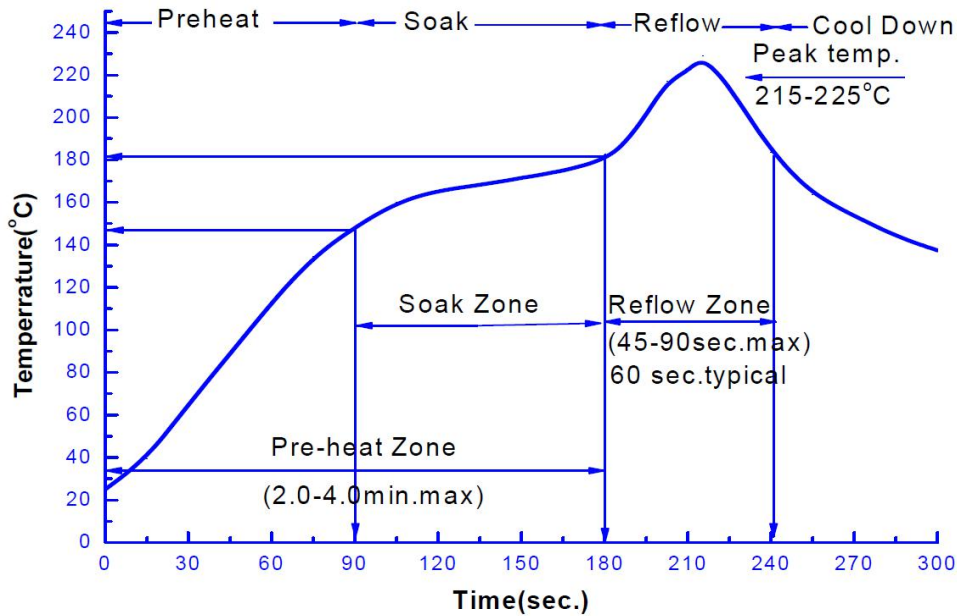
接口标识	接口说明
	RF IN, RF OUT (可互换)
	GND

特性曲线:



产品使用注意事项：

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域），为了保证连接良好，底部引脚焊好之后，需对侧面引脚进行补焊；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 220℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。